

ボイドを抑え、信頼を上げる。

FLF01-MVF(V)

竹の力で、はんだが変わります!!



※イメージ写真

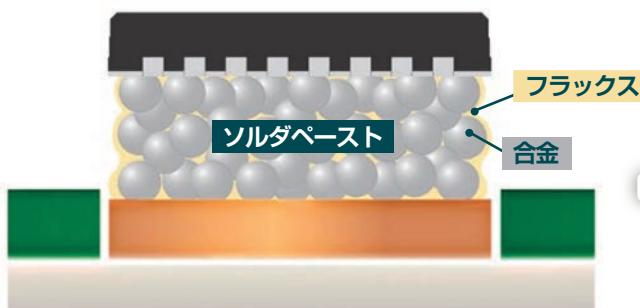
セルロースナノファイバーで実現する、新しいはんだ接合品質

弊社の CNF 含有ソルダペーストは、業界内で初めて採用されてからお客様に愛され続けている量産実績の高いソルダペーストです。

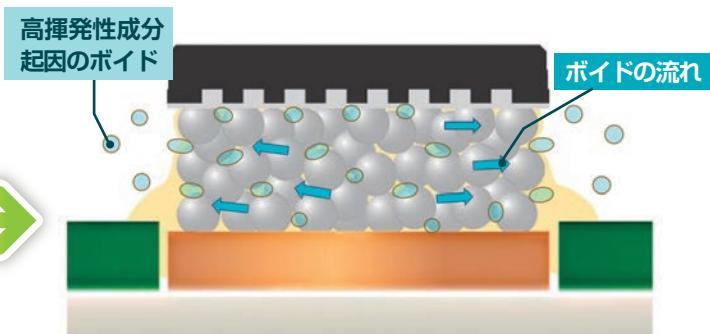
MVF(V) は、その特性と蓄積した技術を元に、改良を重ねた汎用性の高いボイド低減ソルダペーストです。

■ボイド発生のメカニズム

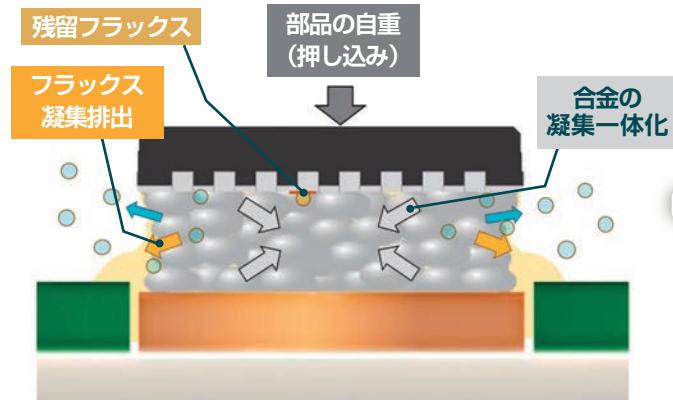
① 印刷～部品マウント～加熱初期



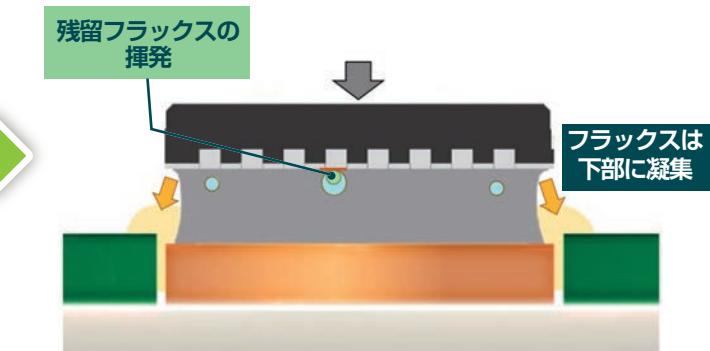
② プリヒート時（はんだ溶融前）



③ 本加熱（はんだ溶融時）

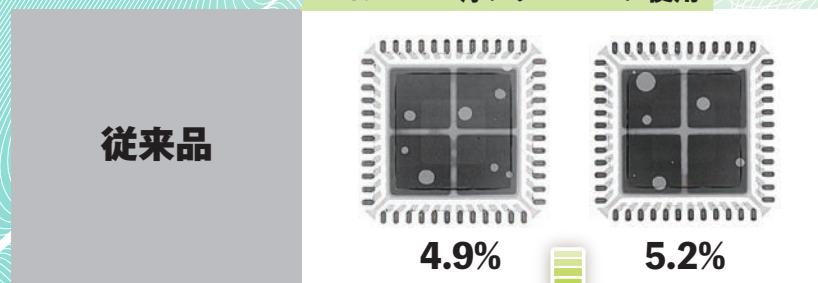


④ ピーク～冷却

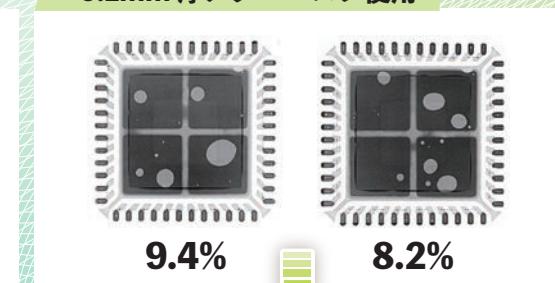


■ボイド低減性能

▼0.12mm 厚メタルマスク使用



▼0.1mm 厚メタルマスク使用



ボイドが
低減！